

BAB IX

KESIMPULAN

1. Perencanaan unit pengemasan dan penggudangan wafer *stick* layak secara teknis dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Prosedur pengemasan yang direncanakan efektif dan efisien.
 - b. Lokasi pengemasan dan penggudangan dekat dengan sumber tenaga kerja, bahan baku, ketersediaan utilitas, dan transportasi.
 - c. Kondisi gudang yang bersih, kering, bebas hama, suhu dan kelembaban yang terjaga, serta mempunyai sirkulasi udara yang baik menjamin keberhasilan penyimpanan wafer *stick*.
 - d. Penggunaan sistem “Arus L” membuat pengaturan arus barang menjadi lebih sistematis dimana barang yang pertama masuk akan keluar lebih dulu (*First In First Out*).
2. Perencanaan unit pengemasan dan penggudangan wafer *stick* akan memberikan beban sebesar Rp 352,70 per kemasan wafer *stick*.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, W.E. 1992. *Plastic in Food Packaging: Properties, Design and Fabrication*. New York: Marcel Dekker, Inc.
- Buckle K. A., R. A. Edwards, G. H. Fleet dan M. Wooton. 1987. *Ilmu Pangan*. (Hari Purnomo dan Adiono, penerjemah). Jakarta: Universitas Indonesia-Press.
- CV. Cipta Manunggal Persada. 2010. *Forklift*. Available at: <http://www.cipta-mp.co.cc/2010/11/sekilas-tentang-kami.html>. 6 Maret 2011.
- CV. Pionir Mandiri Jaya. 2008. *Tangki Air*. Available at: <http://pmjaya.com/wp-content/uploads/2008/06/tangki-air-fiber-silinder.jpg>. 6 Maret 2011.
- Danger, E.P. 1992. *Memilih Warna Kemasan*. Jakarta: PT. Karya Unipress.
- Engineering Toolbox. 2010. *Fuels-Higher Calorific Values*. Available at: http://www.engineeringtoolbox.com/fuels-higher-calorific-values-d_169.html. 10 Mei 2011.
- Erke Trading. 2010. *Conveyor Belt*. Available at: <http://www.erketrading.com/conveyor-belt.htm> 12 April 2011.
- Fan Industri Supply. 2010. *Exhaust Fan*. Available at: <http://indonetwork.co.id/fanindustri-supply/2339002/exhaust-fan-industri-16.htm>. 6 Maret 2011.
- Fellows, P. dan B. Axtell. 1993. *Appropriate Food Packaging*. Amsterdam: Transfer of Technology for Development.
- Industri Kimia. 2009. *Palet*. Available at: <http://industrikimia.com/tag/palet>. 6 Maret 2011.
- Jaya Packaging. 2009. *Mesin Pengemas Primer*. Available at: <http://javapack.indonetwork.co.id/2341991/mesin-pengemas-roti-wafer-sabun-km-1200.htm>. 6 Maret 2011.

- Matz, S. A. 1968. *Cookie and Cracker Technology*. Westport, Connecticut: The AVI Publishing Company, Inc.
- Muchtadi, T., Hariyadi, dan A. Basuki. 1988. *Teknologi Pemasakan Ekstrusi*. Bogor: PAU IPB.
- Peters, M. S., K. D. Timmerhaus, dan R. E. West. 2003. *Plant Design and Economics for Chemical Engineers* (5th edition). New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
- Priyanto, G. 1988. *Teknik Pengawetan Pangan*. Yogyakarta: PAU Pangan dan Gizi, UGM.
- Sultan, W. J. 1969. *Practical Baking, 2nd ed.* AVI Publishing, Connecticut.
- Susanto, T. dan Sucipta. 1994. *Teknologi Pengemasan Bahan Makanan*. Blitar: CV Family.
- Suyitno. 1990. *Bahan-Bahan Pengemas*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Universitas Gadjah Mada.
- Syarief, R., S. Santausa. dan S. Isyana. 1989. *Teknologi Pengemasan Pangan*. Bogor: Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor.
- Syarief, R. dan Halid. 1993. *Teknologi Penyimpanan Pangan*. Jakarta: Arcan.
- Tirto Lancar. 2011. *Pompa Air*. Available at: <http://tirtolancarservice.blogspot.com/> 6 April 2011.
- TopMachineBiz.com. 2011. *Mesin Pengemas Sekunder*. Available at: <http://www.topmachinebiz.com/product/368418/Box-Packing-Machine-ZK-660A.htm> 12 April 2011.
- TopMachineBiz.com. 2011. *Mesin Pengemas Tersier*. Available at: <http://www.topmachinebiz.com/product/409683/Automatic-Carton-Packing-MachineCarton-Packing-Machine.htm> 12 April 2011.

- Wade, P. 1995. *Biscuits, Cookies, and Crackers Volume 1: The Principles of The Craft*. London: Blackie Academic & Professional.
- Warman, J. 1971. *Manajemen Pergudangan*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pembinaan Manajemen dan Sinar Harapan.
- Winarno, F. G. dan Surono. 2002. *GMP Cara Pengolahan Pangan yang Baik*. Bogor: M-Brio Press.
- Y. Pomeranz. 1985. *Functional Properties of Food Component, 1st ed.* San Diego, California: Academic Press, Inc.